



XZIF 양면 고밀도 인터커넥트(XZIF DS-HD)

차세대 고밀도 XZIF(Xandex Zero Insertion Force Interconnect)

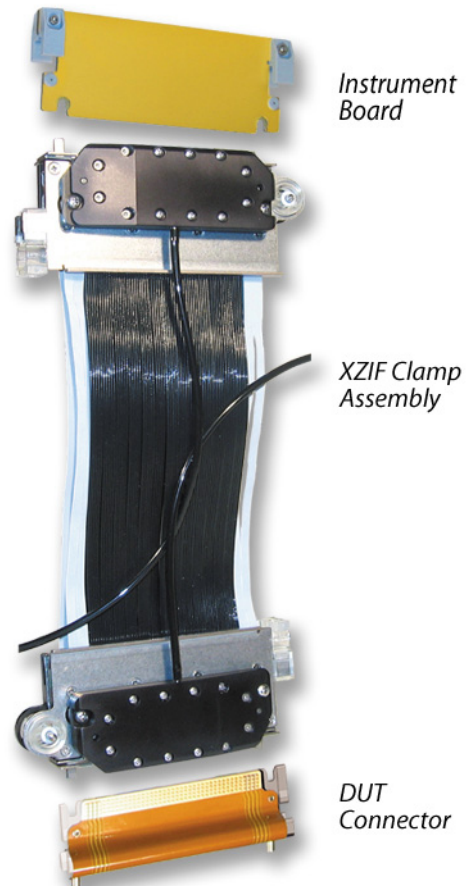
DS-HD(양면 고밀도) XZIF 인터커넥트는 Xandex에서 개발한 차세대 XZIF입니다. DS-HD XZIF 인터커넥트는 접촉 밀도를 높여 비용을 낮추는 동시에 성능은 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

1세대 XZIF 인터커넥트와 비교해 볼 때, DS-HD 전도(electrical path)는 두 배로 강화된 접점 내구성을 통해 매우 뛰어난 대역폭과 성능을 제공합니다.

모듈형 XZIF 인터커넥트는 대부분의 테스트 요건에 맞게 커스터마이징이 가능합니다. 따라서 휘발성/비휘발성 메모리 테스트 애플리케이션 및 SOC 테스트 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션인 동시에, DUT에 동적 고전류 공급을 위한 최선의 솔루션이기도 합니다.

또한 XZIF 인터커넥트는 수직 향력(스프링 프로브)의 방향을 수평(클램프)으로 변경함으로써 DUT 테스트 보드에 걸리는 압력을 거의 90% 감소시킵니다.

HISTC



차세대 XZIF DS-HD 인터커넥트 어셈블리

XZIF DS-HD 인터커넥트 사이클

<p>1) DUT 커넥터가 클램프 어셈블리에 접근합니다.</p>	<p>2) DUT 커넥터가 클램프에 연결되어 클램프 어셈블리에 맞게 정렬됩니다.</p>	<p>3) DUT 커넥터가 클램프에 완전히 끼워지고 약간의 압력이 가해지면서 클램프에 정확하게 고정됩니다.</p>	<p>4) 클램프 공기압 실린더가 작동되면서 DUT 커넥터에 대해 클램프의 양면에 강한 압력이 가해집니다.</p>





슬림한 XZIF DS-HDn(XZIF Double Sided-High Density Interconnect: 양면 고밀도 인터커넥트)

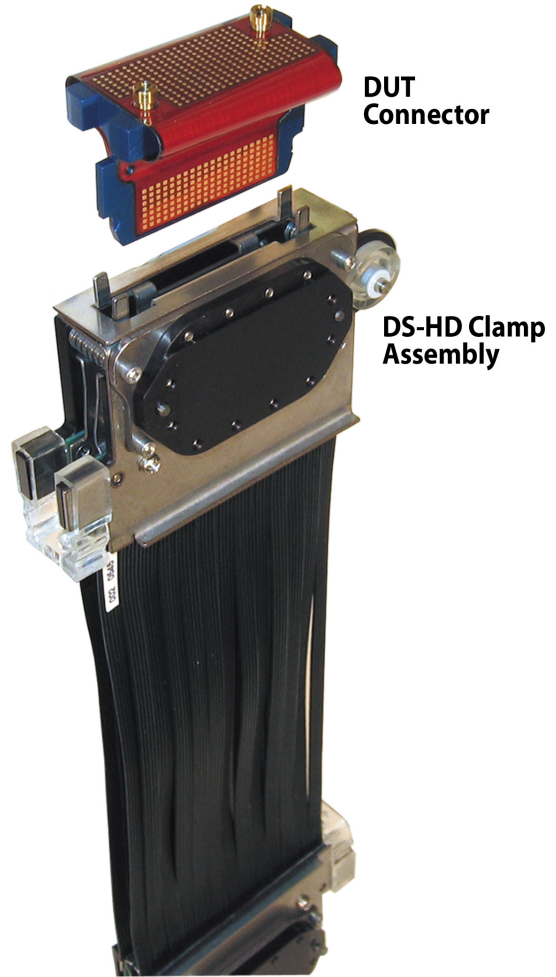
고밀도 메모리 테스트 애플리케이션을 위해 슬림한 폼팩터를 갖춘 고밀도 XZIF (Xandex Zero Insertion Force Interconnect)

슬림한 폼팩터의 양면 고밀도(DS-HD) XZIF 인터커넥트는 메모리 테스트를 위해 Xandex에서 개발한 차세대 XZIF입니다. DS-HDn XZIF 인터커넥트는 접촉 밀도를 높이고 비용을 낮추는 동시에 성능을 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

1세대 XZIF 플렉스 인터커넥트와 비교했을 때, DS-HDn XZIF는 인터포저 기술을 사용하여 채널 밀도가 높고 DC 접촉 저항이 우수합니다.

모듈형 XZIF 인터커넥트는 대부분의 테스트 요건에 맞게 커스터마이징이 가능합니다. 따라서 휘발성/비휘발성 메모리 테스트 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션입니다. 슬림한 폼팩터 클램프는 외부 제한 영역이 큰 소형 프로브 카드(300 + mm)나 대형 프로브 카드(440 + mm)에 특히 유용합니다.

또한 XZIF 인터커넥트는 수직 향력(스프링 프로브)의 방향을 수평(클램프)으로 변경함으로써 DUT 테스트 보드에 걸리는 압력을 거의 90% 감소시킵니다.

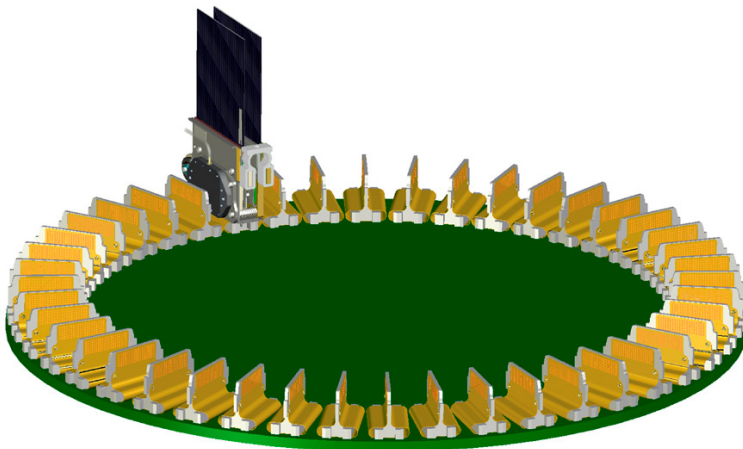


HISTC

차세대 XZIF DS-HDn 인터커넥트 어셈블리

고밀도: 440mm 프로브 카드당 접점: >13,000

2 개의 나사를 사용하여 바로 교체할 수 있는 XZIF DUT 커넥터





스펙:

고밀도	
어셈블리당 DS-HD 접점:	344
1인치당 접점:	>100
440mm 프로브 카드당 접점:	>13,000

낮은 삽입 항력	
어셈블리당 평균 항력	5lb [2.3kg]
어셈블리당 최대 항력	<9lb [4kg]
13k 접촉 시 XZIF	190lb [86kg]
13K 접촉 시 스프링 핀 (핀당 2.2oz)	1790lb [812kg]

높은 신뢰성	
다중 접점:	접촉당 12포인트
접촉 와이프:	예
적은 힘에 의한 높은 접속력:	> 50g
일반 접촉 저항:	<10mΩ
최대 접촉 저항:	< 50mΩ 접촉 저항(10k 수명)

고성능	
<i>고속 구성</i>	
연결성 (어셈블리당):	132개 동축 채널 및 56개 유틸리티
-3db 대역폭:	> 4GHz
임피던스 제어:	50Ω ± 2.5Ω @ 100ps Tr ₁₀₋₉₀
크로스 토크:	<2% FEXT/NEXT @ 500ps Tr ₁₀₋₉₀
<i>고성능 구성</i>	
어셈블리당 감도 전류:	325A
총 루프 저항:	< 2mΩ
총 루프 저항:	< 500pH
깊어진 접촉 수명	
최소 접촉 사이클 횟수:	10k

유지 보수	
DUT 보드 커넥터:	자동 정렬 DUT 보드 커넥터는 현장에서 신속하게 교체 가능

HISTORY

